

8 処置について

項 目	略 称
う蝕処置	う蝕
咬合調整	咬調
歯髄保護処置	P C a p
歯髄温存療法	A I P C
直接歯髄保護処置	直保護、直覆又は直P C a p
間接歯髄保護処置	間保護、間覆又は間P C a p
知覚過敏処置	H y s 処
乳幼児う蝕薬物塗布処置	サホ塗布
初期う蝕早期充填処置	填塞又はシーラント
生活歯髄切断	生切
失活歯髄切断	失切
麻酔抜髄	麻抜
感染根管処置	感根処
根管貼薬処置	根貼又はR C T
根管拡大	拡大
根管形成	R C P
根管充填	根充又はR C F
加圧根管充填処置	C R F
抜髄と同時の根管充填	抜髄即充
感染根管処置と同時の根管充填	感根即充

歯周疾患処置	P 処
歯石除去	除石
スケーリング	S C
スケーリング・ルートプレーニング	S R P
歯周ポケット搔爬	P C u r
歯周病安定期治療	S P T
歯周基本治療処置	P 基処
暫間固定	T F i x
根管内異物除去	R B I
有床義歯床下粘膜調整処置又はティッシュコ ンディショニング	T. コンデ又はT. c o n d
周術期専門的口腔衛生処置	術口衛
機械的歯面清掃処置	歯清
フッ化物歯面塗布処置	F 局